



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき
 - 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
 - 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。
- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
 - THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

PRINT DIST
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

⑥	④	1-178295-5
⑥	③	1-178295-3
⑥	②	1-178295-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

B1	REVISED (ECR-08-027321)	T S	S.M.	29OCT 2008	
B	REVISED (FJD0-0039-03)	T S	S.M.	6/02 03	
A	REVISED (FJD0-0097-03)	T S	S.M.	4/15 03	
0	RELEASED (ECN J1184)	NM	H.O. S.M.	7-1 -92	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	

Copyright © 1991
 AMP(Japan) LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation
 Kawasaki, Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
mm ² (AWG -)	mmφ	5 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	SIZE LOC NUMBER A3 J C-178295
DR. N. Matsubara 14 JUN 91	DE. N. Matsubara 14 JUN 91	10% ±0.3 30% ±0.4 30% ±0.5 角 度 ±3°
CHK. T. Obata 1 JUL '91	APP. S. MANABE 1-JUL-'91	SCALE REV. SHEET 2-1 B1 1 of 1